【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年3月12日(2015.3.12)

【公開番号】特開2012-160733(P2012-160733A)
【公開日】平成24年8月23日(2012.8.23)
【年通号数】公開・登録公報2012-033
【出願番号】特願2012-18422(P2012-18422)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　23/02　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　23/08　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　23/04　(2006.01)
Ｂ８１Ｃ　 3/00　(2006.01)
Ｂ８１Ｂ　 7/02　(2006.01)
Ｇ０１Ｐ　15/08　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　23/02　Ｇ
Ｈ０１Ｌ　23/08　Ｂ
Ｈ０１Ｌ　23/04　Ｅ
Ｂ８１Ｃ　 3/00
Ｂ８１Ｂ　 7/02
Ｇ０１Ｐ　15/08　Ｐ

【手続補正書】
【提出日】平成27年1月27日(2015.1.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
センサダイパッケージであって、
第１のガラス層に結合された、センサデバイスを含むシリコンの機械層、
シリコンの前記機械層に付着された第２のガラス層、
シリコンの前記機械層の表面の予め定められた領域を露出させるように構成された、前記第１または第２のガラス層の少なくとも１つの中の少なくとも１つの第１のビア、
第１または第２のガラス層の少なくとも１つ中の少なくとも１つの第２のビアであって、前記第１または第２のガラス層の少なくとも１つをシリコンの前記機械層まで貫通していない前記少なくとも１つの第２のビア、および
シリコンの前記機械層の前記露出された領域と前記少なくとも１つの第２のビアの少なくとも一部との間に位置する金属トレース
を備えるセンサダイパッケージ。
【請求項２】
請求項１に記載のセンサダイパッケージにおいて、前記少なくとも１つのセンサデバイスは、加速度センサ又はジャイロのうち少なくとも１つである、センサダイパッケージ。
【請求項３】
第１のガラス層に結合されるシリコンの機械層中に少なくとも１つのセンサデバイスを作るステップと、
第２のガラス層をシリコンの前記機械層に付着させてウェーハを作るステップと、

シリコンの前記機械層の表面の予め定められた領域を露出させるために、前記第１または第２のガラス層の少なくとも１つに少なくとも１つの第１のビアを作るステップと、
少なくとも１つの第２のビアを、前記第１または第２のガラス層の少なくとも１つに作るステップであり、前記少なくとも１つの第２のビアは、該第１または第２のガラス層の少なくとも１つをシリコンの前記機械層まで貫通しない前記ステップと、
シリコンの前記機械層の前記露出領域と前記少なくとも１つの第２のビアの少なくとも一部との間に金属トレースを付けるステップと、
前記少なくとも１つの第２のビアが２つの部分に分けられるように前記ウェーハをスライスして、第１のセンサダイを作るステップと、
前記第１のセンサダイを、前記スライスされた第２のビアの壁の残りの一部のところで回路基板に電気的かつ機械的に結合するステップと
を含む方法。